

立即发布

投资者关系：

Ed Lockwood

投资者关系高级总监

(408) 875-9529

ed.lockwood@kla-tencor.com

媒体关系：

Meggan Powers

企业宣传高级总监

(408) 875-8733

meggan.powers@kla-tencor.com

## KLA-Tencor 宣布推出 X5.2™ 和 Teron™ 611 光罩检测系统

*集成电路厂进行光罩监测的全面 ReQual™ 解决方案*

【加州 MILPITAS 2012 年 9 月 5 日讯】 [KLA-Tencor 公司](#) ( 纳斯达克股票代码：KLAC ) 今天宣布，该公司为集成电路厂推出两款新型光罩检测产品：X5.2™ 和 Teron™ 611 系统。作为成功的 5XX 产品线的最新产品，新的 X5.2 系统具备极高性能，不仅能够捕捉目前生产中光罩上的缺陷与图案退化，并且具备扩展至将来 20 纳米节点的能力。Teron 611 设计用于 20 纳米及更小节点，为最先进的集成电路生产提供所需的光罩检测灵敏度。

KLA-Tencor 光罩产品事业部总经理熊亚霖博士说明：“新的清洁工艺和光罩上的更小图案特性改变了集成电路厂的光罩检测需求。20 纳米的主要和辅助图案不仅在于尺寸更小，而且相互的差异也变得模糊，更加难以判断某个缺陷是否会影响硅片上的图案。我们的客户还越来越担心因重复清洁与曝光导致光罩图案退化对工艺窗口造成的影响。我们设计的 X5.2 和 Teron 611 检测系统，构成全面 ReQual™ 解决方案，对 20 纳米及更小节点的缺陷率和图案退化进行监测。”

X5.2 和 Teron 611 系统的全面能力包括：

- 提供检测 20 纳米节点最关键光罩的所需的灵敏度 (Teron 611) ；
- 具有对其余的 20 纳米光罩系列和 28 纳米及更大设计节点全套光罩系列的极高灵敏度 (X5.2) ；
- 及早侦测清洁或曝光造成的图案退化，旨在光罩失效前提醒工程师工艺窗口变窄；
- 全面覆盖多芯片与单芯片光罩的第五代 STARlight® 检测模式；优先捕捉图案边缘及侧壁上的缺陷；以及捕捉开阔区域中缺陷的可靠能力；

- 可有效分辨杂讯缺陷与关键缺陷 (DOI) 的先进算法；
- 高度灵活的产品架构，可调节灵敏度和速度，以适应集成电路厂不断变化的产品组合、产品寿命周期和成品率情况；
- 为先进设计节点提供业界领先产能的可选配置 (X5.2)；以及
- 与 KLA-Tencor 的 eDR-7000 电子束检测平台相连的独有能力，能提高对硅片上的缺陷群进行特征分析的速度和精确度。

X5.2 和 Teron 611 系统已经向美国及亚洲的领先芯片制造商发货，已用于 28 纳米量产和 20 纳米试产线。为了保持高性能和高生产力，X5.2 和 Teron 611 系统由 [KLA-Tencor 的全球综合服务网络](#) 提供支持。关于 KLA-Tencor 的集成电路厂光罩检测设备的更多信息，请访问产品网页：<http://www.kla-tencor.com/front-end-defect-inspection/rapid-ic-fab-series.html>。

#### **关于 KLA-Tencor：**

KLA-Tencor 公司是工艺控制与成品率管理解决方案的领先提供商，它与全球客户合作，开发先进的检测与量测技术。这些技术为半导体、数据存储、发光二极管 (LED)、光伏及其他相关纳米电子产业提供服务。公司拥有广泛的业界标准产品系列及世界一流的工程师与科学家团队，超过三十五年以来一直致力于为客户打造优秀的解决方案。KLA-Tencor 的总部设在美国加利福尼亚州米尔皮塔斯 (Milpitas)，并在全球各地设有专属的客户运营与服务中心。如需更多信息，请访问网站 [www.kla-tencor.com](http://www.kla-tencor.com) (KLAC-P)。

#### **前瞻性声明：**

本新闻稿中除历史事实以外的声明，例如关于 X5.2 或 Teron 611 系统的预期性能，半导体产业的趋势及其带来的预期挑战，KLA-Tencor 的客户对 X5.2 或 Teron 611 系统的预期使用，X5.2 或 Teron 611 系统提供新功能的预期可扩展性，以及 X5.2 或 Teron 611 系统使用者可以实现的预期成本、运营与其他受益等陈述，均为前瞻性声明，并受到《1995 年美国私人证券诉讼改革法案》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 规定的“安全港”(Safe Harbor) 条款的制约。这些前瞻性声明基于当前信息及预期，且包含诸多风险与不确定性。由于各种因素，包括延迟采用新技术（无论是由于成本或性能问题抑或其他问题），其他公司推出竞争性产品，或影响 KLA-Tencor 产品的实现、性能或使用的意外技术挑战或限制，实际结果可能与此类声明中的预计结果实质不同。

###